

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

1、为满足业务发展需要，北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东长兴半导体科技有限公司（以下简称“长兴半导体”）近日与中国民生银行股份有限公司东莞分行（以下简称“民生银行东莞分行”）签署了《综合授信合同》（以下简称“主合同1”），民生银行东莞分行向长兴半导体提供流动资金贷款，授信额度最高限额为人民币 1,000 万元，期限为一年。

公司与民生银行东莞分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“《保证合同1》”），就上述事项提供不可撤销连带责任保证担保，保证期限为债务履行期限届满日起三年。

2、为满足业务发展需要，公司控股子公司长兴半导体与平安银行股份有限公司东莞分行（以下简称“平安银行东莞分行”）签署了《综合授信额度合同》（以下简称“主合同2”），公司与平安银行东莞分行签署了《最高额保证担保合同》，就上述事项提供最高额连带责任保证担保，其中担保债务最高本金余额为人民币 8,000 万元，保证期限为从前述《最高额保证担保合同》生效日起至主合同2项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。具体内容请详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-031）。

近日，公司间接持有的控股子公司江苏长耀半导体科技有限公司（以下简称“长耀半导体”）与平安银行东莞分行签署《最高额保证担保合同》（以下简称“《保证合同2》”），就长兴半导体上述融资事项提供最高额连带责任保证担

保，担保债务最高本金余额为人民币 8,000 万元，保证期间为从《保证合同 2》生效日起至主合同 2 项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。

（二）公司决策程序履行情况

公司分别于 2026 年 4 月 27 日及 2026 年 6 月 30 日召开第十一届董事会第二十次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》，公司对未来十二个月为合并报表范围内各级子公司及控股子公司之间提供担保的额度进行了合理预计，预计为资产负债率 70%（含）以上的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 30 亿元，为资产负债率低于 70% 的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 30 亿元，合计预计新增担保额度不超过人民币 60 亿元。长兴半导体的资产负债率低于 70%，本次担保前，公司为长兴半导体提供的担保余额为 1.30 亿元，本次公司为长兴半导体提供的担保金额为 0.10 亿元，长耀半导体为长兴半导体提供担保为增加担保措施，不涉及新增担保金额，故本次担保后，公司为长兴半导体提供的担保余额为 1.40 亿元，此次获批的资产负债率 70%（含）以上剩余可用担保额度 30 亿元，资产负债率 70%以下剩余可用担保额度为 28.48 亿元。上述事项已经公司内部决策程序通过，涉及的金额在公司 2025 年年度股东会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东会审议。

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本年度担保授权资产负债率 70%以下总额	已使用资产负债率 70%以下的担保额度	本次使用担保额度	本次担保后资产负债率 70%以下授权担保的余额	此次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	长兴半导体	60.00%	65.22%	300,000	14,200	1,000	284,800	0.26%	否
长耀半导体						0		0%	否

二、被担保人基本情况

被担保人名称：广东长兴半导体科技有限公司

住所：广东省东莞市松山湖园区科技九路2号2栋101室、201室、301室、501室

成立日期：2012年11月30日

法定代表人：张治强

注册资本：人民币6,111.7922万元

经营范围：一般项目：电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；专业设计服务；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权关系：

股东名称	持股比例（%）
北京盈新灵境半导体科技有限公司	60.0000
海南兴煜投资有限公司	13.5682
张治强	8.1809
东莞市昌华项目投资合伙企业（有限合伙）	8.0582
钟宏标	5.4338
南通双佳投资有限公司	3.8100
东莞市昌丰项目投资合伙企业（有限合伙）	0.9490
合计	100.00

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况系四舍五入原因造成。

截至2025年12月31日（经审计），长兴半导体资产总额61,736.30万元，负债总额42,080.03万元（其中银行贷款总额17,372.50万元、流动负债总额40,630.62万元），净资产19,656.26万元；2025年度营业收入65,372.20万元，利润总额7,632.65万元，净利润6,920.15万元。

截至2026年6月30日（未经审计），长兴半导体资产总额96,211.41万元，负债总额62,746.45万元（其中银行贷款总额27,070.00万元、流动负债总额57,255.39万元），净资产33,464.96万元；2026年1-6月营业收入52,328.20万元，利润总额15,869.87万元，净利润13,783.91万元。

长兴半导体未进行过信用评级，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、公司与民生银行东莞分行签署了《保证合同 1》，就上述事项提供不可撤销连带责任保证担保，保证期限为债务履行期限届满日起三年。保证范围为主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权和担保权利的费用。

2、长耀半导体与平安银行东莞分行签署《保证合同 2》，就长兴半导体上述融资事项提供最高额连带责任保证担保，担保债务最高本金余额为人民币 8,000 万元，保证期间为从《保证合同 2》生效日起至主合同 2 项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。保证范围为债权确定期间内主合同 2 项下债务人长兴半导体所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。

四、董事会意见

公司间接持有长兴半导体 60.00%的股权，并在董事会成员中占绝对多数，对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，因此长兴半导体此次融资事项由公司提供担保。长兴半导体为公司纳入合并报表范围内子公司，公司为其提供担保的同时，自然人张治强、李小丽亦为本次融资事项提供连带责任保证担保（张治强及其配偶通过海南兴煜投资有限公司持有长兴半导体 13.5682%的股权，张治强直接持有长兴半导体 8.1809%的股权），担保风险可控。上述担保是基于长兴半导体实际经营考虑，符合公司日常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 16.60 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 43.83%。除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，逾期债务对应的担保本金余额为 2.47 亿元，涉及未决诉讼的担保金额为 4.33 亿元。

六、备查文件

1、相关协议文本；

- 2、公司第十一届董事会第二十次会议决议；
- 3、公司 2025 年年度股东会决议。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日